PRODUKT DES MONATS · NOVEMBER 2026

SC BLF09 LOTPASTE

Weniger Stickstoffbedarf. Geringes Voiding.

Lotpasten aus deutscher Produktion – neu bei AdoptSMT.

Solder Chemistry BLF09 ist eine No-Clean-Lotpaste, die speziell für Reflow-Prozesse in Luftumgebung entwickelt wurde. Je nach Anwendung lässt sich dadurch Stickstoff einsparen oder ganz vermeiden. Die bleifreie, halogenfreie No-Clean-Lotpaste ist auf geringe Hohlraumbildung ausgelegt.



FÜR IHREN LÖTPROZESS

- ✓ Stickstoffbedarf je nach Anwendung reduzieren oder vermeiden
- ✓ Low Voiding bei BGA, CSP und QFN
- ✓ Stabile Druckergebnisse auch bei Produktionspausen

LEGIERUNGEN IM ÜBERBLICK

Legierung	Silberanteil	Korngröße
SAC305	3,0 %	Typ 3 / 4
SAC105	1,0 %	Typ 3 / 4
SAC0307	0,3 %	Typ 3 / 4

Auswahl aus dem BLF09-Datenblatt.

Stickstoffeinsparung und Hohlraumbildung sind anwendungsabhängig. Die Eignung wird mit der jeweiligen Baugruppe und dem Reflow-Profil im Prozessversuch geprüft.

PRODUKTDATENBLATT

Scannen Sie den QR-Code für technische Daten.

SC BLF09 FÜR IHREN PROZESS

Jetzt unverbindlich anfragen

info@adoptsmt.com